



## Fiche technique

### RS 554-311 : Compound pour dissipateur

Le compound pour dissipateur est recommandé lorsqu'un couplage thermique fiable de composants électriques et électroniques est nécessaire ou entre n'importe quelle surface où la conductivité thermique ou la dissipation de chaleur est importante. Il doit être appliqué sur la base et les goujons de montage des diodes, transistors, thyristors, dissipateurs, redresseurs au silicium et semi-conducteurs, thermostats, résistances de puissance et radiateurs.

Elle est basée sur une huile à base de silicone et offre ainsi une large plage de températures d'utilisation et une excellente stabilité à des températures élevées.

- Plage de températures d'utilisation extrêmement large
- Excellente conductivité thermique même à haute température
- Faible toxicité
- La couleur blanche permet de distinguer facilement les parties traitées.
- Faible perte de poids à l'évaporation

**Homologations**      **conformité RoHS-2 (2011/65/UE) :**      **Oui**

<b>Propriétés :</b>	Couleur :	Blanc
	Base :	Huile de silicone
	Composant thermo-conducteur :	Oxydes métalliques
	Conductivité thermique :	0,65 W/m.K
	Densité, 20 °C :	2 g/cm <sup>3</sup>
	Indice de température :	De -40 °C to +200 °C
	Perte de poids après 96 heures à 100 °C :	< 1 %
	Résistance ( )	1 x 10 <sup>14</sup> Ω / cm
	Rigidité diélectrique :	16 kV/mm
	Pénétration	310

### **MODE D'EMPLOI :**

Appliquer un film mince sur la base et les goujons de montage de nombreux types de composants, y compris les diodes, transistors, thyristors, dissipateurs de chaleur, redresseurs en silicone, semi-conducteurs, thermostats, résistances de puissance et radiateurs.

Les composés caloporteurs peuvent être appliqués par diverses méthodes, y compris la sérigraphie, le brossage et l'utilisation d'un rouleau.